

Kompaktdosierzelle DC-CNC800 vereint Flexibilität und Dynamik

Bondexpo 2018: RAMPF Production Systems präsentiert leistungsstarke Dosieranlage und patentiertes Optical-Bonding-Verfahren

© RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG

Seite 1 von 3

Zimmern o. R., 24.09.2018. Kompakt, flexibel, leistungsstark – und live in Action am Stand von RAMPF Production Systems: die Dosieranlage DC-CNC800 für dynamisches Dichten, Kleben und Vergießen auf der Bondexpo 2018 vom 8. bis 11. Oktober in Stuttgart – Halle 6 / Stand 6404.

Die Kompaktdosieranlage DC-CNC800 verfügt über eine integrierte Materialaufbereitung und kann mit Kolben- oder Zahnradpumpen ausgestattet werden. Für die modulare Steuerung stehen eine CNC Siemens-Sinumerik-Steuerung sowie Beckhoff-Steuerungstechnologie zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt: die integrierte Prozessüberwachung zur Kontrolle von Drücken, Füllständen und Drehzahlen.

Die DC-CNC800 kann mit einem HD-Spülmittelrückführsystem oder HD-Wasserspülung, anwendungsabhängigen Automatisierungseinrichtungen sowie dem Mischsystem MS-C für Dosierleistungen ab 0,1 g/sec ausgestattet werden.

Weitere Features: standardisierte Bedienkonzepte für Schiebetisch, Rundschaltteller und Bandzuführung sowie Vakuumfasspressen. Aufgrund der großen Tanks können Kleingebinde komplett in einem Vorgang umgefüllt werden. Die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten zu den Kolben- und Zahnradpumpen sowie der Steuerung ist optimal gestaltet.

Die DC-CNC800 können Besucher der Bondexpo live in Action sehen: Am RAMPF-Stand wird die Anlage eine Vergussanwendung verarbeiten.



Die Kompaktdosieranlage DC-CNC800 ist die ideale Lösung für Anwender, für die ein kompakter Maschinenaufbau ein Muss ist und Kompromisse in der Steuerungstechnik keine Option sind.

Kompaktdosierzelle DC-CNC800 vereint Flexibilität und Dynamik

Bondexpo 2018: RAMPF Production Systems präsentiert leistungsstarke Misch- und Dosieranlage und patentiertes Optical-Bonding-Verfahren

Optical Bonding: Vakuumauftrag für beste Ergebnisse

Ein weiteres Highlight der Bondexpo 2018: das von RAMPF entwickelte und in Teilen patentierten Optical-Bonding-Verfahren für den prozesssicheren, luftblasenfreien Auftrag von Bondingmaterialien auf Displays in den Bereichen Automotive, mobile Geräte, GPS, Industriemonitore, Navigationsgeräte und Wearables.

Beim Optical-Bonding-Verfahren werden Display und Touchglas / Deckglas aufeinander gelegt und die Luft dazwischen mithilfe einer extrem klaren Bondingmasse ausgeschlossen. Dadurch wird vermieden, dass aufgrund der unterschiedlichen Brechungsindizes von Glas und Luft Parallaxenfehler auftreten, die den Betrachter durch Unschärfe und schlechtere Seitenansicht beeinträchtigen. Da die Vergussmasse annähernd denselben Brechungsindex wie Glas hat, entsteht ein deutlich schärferes Bild und eine stark verbesserte Seitensichtbarkeit.

Bei dem von RAMPF entwickelten Verfahren wird die Bondingmasse unter Vakuum aufgetragen und die Bauteile werden unter Luftabschluss im Vakuum gefügt. Durch die Dünnschicht-Entgasungstechnologie der Einzelkomponenten ist die Verarbeitung hochevakuiertes Bondingmaterialien möglich. So wird das Risiko minimiert, dass beim Füge- und Aushärteprozess Luftblasen eingeschlossen werden.

Der Auftrag der Bondingmasse erfolgt mit der RAMPF-Vakuumdosieranlage DC-VAC. Die Anlage ist für die Verarbeitung von ein- und zweikomponentigen Vergussmassen ausgelegt, verfügt serienmäßig über eine Vakuummaterialaufbereitung und ist mit einem dynamischen Mischsystem ausgestattet.

Die DC-VAC wird mit C-DS-Klebe- und Montageeinheiten, Robotersystemen, Fördersystemen sowie Prozesssteuerungssystemen zu einem vollautomatischen, kundenspezifischen Produktionssystem kombiniert. Zusätzlich zum Display-Fügeverfahren unter Vakuum beinhalten die von RAMPF konzipierten vollautomatischen Produktionssysteme alle Arbeitsschritte zum Handeln, Ausrichten und Verkleben des Displays mit dem Rahmen sowie eine abschließende Qualitätskontrolle.



Vakuumdosieranlage DC-VAC von RAMPF für das Dosieren anspruchsvollster Materialien.

Kompaktdosierzelle DC-CNC800 vereint Flexibilität und Dynamik

Bondexpo 2018: RAMPF Production Systems präsentiert leistungsstarke Misch- und Dosieranlage und patentiertes Optical-Bonding-Verfahren

www.rampf-gruppe.de



Die **RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG** entwickelt und produziert Misch- und Dosieranlagen zum Dichten, Vergießen und Kleben verschiedenster Materialien. Zudem verfügt das Unternehmen über umfassende Automatisierungskompetenz rund um die Verfahrenstechnik.

Mit weltweit über 3.000 Systemlösungen am Markt gehört RAMPF Production Systems mit Sitz in Zimmern o. R. zu den führenden Anbietern von innovativen Anlagen für die Verarbeitung von ein-, zwei- und mehrkomponentigen Reaktionsharzsystemen.

Zusätzlich zur Kernkompetenz Misch- und Dosiertechnik werden Kunden erweiterte Automatisierungs- und Fördersysteme für die innerbetriebliche Logistik, zusätzliche Technologien der Montage- und Fügetechnik sowie logistische und qualitätssicherungsrelevante Lösungen angeboten. Auch Prüf- und Messtechnik-Integrationen in die Produktionsanlagen zur Absicherung der Produktionsprozesse sind Teil der kundenspezifischen Lösungen.

Mit diesem Mehrwert liefert RAMPF Production Systems gesamtheitliche Systemlösungen für die Produktionen seiner Kunden.

RAMPF Production Systems ist ein Unternehmen der internationalen **RAMPF-Gruppe** mit Sitz in Grafenberg bei Stuttgart.

Herausgeber:
RAMPF Production Systems **GmbH & Co. KG**
Römerallee 14
78658 Zimmern o. R.
T +49.741.2902-0
F +49.741.2902-2100
E production.systems@rampf-gruppe.de
www.rampf-gruppe.de

Ihr Ansprechpartner für Bildmaterial und weitere Informationen:
Benjamin Schicker
RAMPF Holding GmbH & Co. KG
Albstraße 37
72661 Grafenberg
T + 49.7123 9342-1045
F + 49.7123 9342-2045
E benjamin.schicker@rampf-gruppe.de